



Телефон: +7 (495) 223-34-46  
Email: [prodam@protonrf.ru](mailto:prodam@protonrf.ru)

125430, Москва, ул.  
Фабричная, д.6,  
Фабрика «Победы труда»

## KOKI SS(SE)58-M955 LV. Паяльная паста с низким формированием пустот



Высокопроизводительная безотмывочная паяльная паста с низким формированием пустот, размер частиц 20 ~ 38  $\mu\text{m}$ , время жизни после нанесения более 24 часов, флюс ROL 0 (слабоактивный, не требующий отмытки), содержание флюса 9,3%. Поставляется в упаковке: банка 0,5 кг.

- Использование 20 ~ 38 микронного паяльного порошка обеспечивает непрерывную печать с шагом 0,5 мм (20 mil) и качественную печать с шагом 0,4 мм (16 mil).
- Тщательно подобранный состав флюса гарантирует низкое формирование пустот.
- Продолжительное время жизни на трафарете гарантирует длительное технологическое окно.
- Бесцветные остатки флюса обеспечивают отличный косметический вид и не препятствуют контролю качества.
- Соответствует тестам Bellcor (коррозия медной пластины, содержание галогенов, сопротивление изоляции остатков, электромиграции) GR-78-CORE, выпуск 1.

### Спецификация

Сплав				
	SE58-M 955 LV	SS58-M 955 LV	SSA58-M 955 LV	Примечания

<b>Состав сплава (%)</b>	Sn 63%, Pb 37%	Sn 62%, Pb 36%, Ag2%	Sn 62,6%, Pb 36,8%, Ag 2%, Sb 0,2%	JIS E grade	
<b>Форма частиц</b>	Сферическая	???????????	???????????	Микроскоп x50	
<b>Размер частицы</b>	20 ~ 38	20 ~ 38	20 ~ 38	--	
<b>Точка плавления (°C)</b>	183	179 ~ 183	179 ~ 190	--	
<b>Содержание галогенов (%)</b>	0,00	0,00	0,00	Потенциометр	
<b>SIR * 1</b>	<b>до увлажнения (Ом)</b>	$> 1 \times 10^{12}$	$> 1 \times 10^{12}$	$> 1 \times 10^{12}$	JIS comb тип электрод тип I I
	<b>после увлажнения (??)</b>	$> 1 \times 10^{11}$	$> 1 \times 10^{11}$	$> 1 \times 10^{11}$	
<b>Удельное сопротивление водного раствора Ом*см * 2</b>	$> 5 \times 10^4$	$> 5 \times 10^4$	$> 5 \times 10^4$	Электропроводность	
<b>Тип флюса</b>	ROL 0	ROL 0	ROL 0	ANSI/J-STD-004	
<b>Содержание флюса (%)</b>	9,3			На вес	
<b>Вязкость * 3 Pa.s</b>	1900 + 20			Malcom PCU-205	
<b>Коррозия медной пластины * 4</b>	Соответствует			--	
<b>Коэффициент распространения припоя (%)</b>	90			Медная пластина	
<b>Время жизни после нанесения</b>	> 24 часов			Malcom FG-1	
<b>Срок годности с даты производства</b>	6 месяцев			0 ~ 10 °C	
	1 месяц			при + 20 °C	
	1 месяц			при + 30 °C	

\* 1 SIR: 40°C x 90%RH x 96Hr

\* 2 удельное сопротивление водного раствора: в соответствии со спецификациями MIL

\* 3 вязкость: вискозиметр Malcom спирального типа, PCU-205 при 25 °C, 10 об/мин

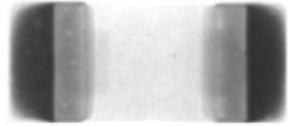
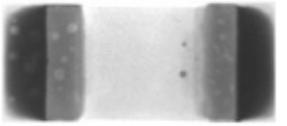
\* 4 коррозия медной пластины: в соответствии с JIS

## Рекомендуемый термопрофиль

Термопрофиль SS58-M955 LV

Image not found or type unknown

## Низкое формирование пустот (рентгеновский снимок)

Component		SS58-M955LV	Обычная паста
2125 Chip resistor	1		
	2		
	3		
	4		
2125 Chip condenser	1		
	2		

Техническая документация

[Техническая информация SS\(SE\)58-M955 LV \(ENG\)](#)

## **Дополнительная информация**

[Хранение паяльных материалов. Часто возникающие вопросы](#)